



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



## Скоростной автомат установки SMD компонентов MR20LP

### Технические характеристики

Параметры	MR20LP
Производительность (Optimal condition)	19,500 ком/час (0,184 sec/chip)
Производительность по стандарту IPC9850	Для Chip 15,000 ком/час (0,24 sec/chip)
	Для QFP 7,500 ком/час (0,48 sec/chip)
Точность установки по 3σ (chip)	± 50μm
Точность установки по 3σ (QFP)	± 25μm
Количество захватов	4 Precision
Мин. размер Печатной платы	50 x 50 x 0,4 мм
Макс. размер Печатной платы	700 x 510 x 5,0 мм
Диапазон размеров устанавливаемых компонентов	От 0402 (01005 -опция) до 50 x 50мм, 90 x 30мм
Типы компонентов	Chip, melf, BGA (50 на 50 шаров), микросхемы, коннекторы, нестандартные компоненты
Мин. шаг выводов микросхем	0,3 мм
Мин. шарик BGA	0,2 мм
Мин. шаг шариков BGA	0,2 мм
Макс. высота компонента	25 мм
Мин. расстояние расположения компонента от края платы	2 мм
Макс. Количество питателей (8мм)	60 шт. (базовая комплектация), 120 шт. (опция)
Скоростные ленточные питатели	8, 12, 16, 24, 32, 44, 56, 72, 88 мм
Другие типы питателей	Вибропитатель для пеналов, поддоны
Фиксация печатной платы	Боковые зажимы, подъемные штыри
Тип приводов по осям XY	Линейный двигатель 4го поколения
Электропитание	3 фазы, 380 В, 50 Гц, 5 КВА
Давление воздуха	5,5 атм; 90 Нл/мин
Масса	1700 кг
Габариты (Ш × Г × В)	1490 x 2090 x 1500 мм (только корпус)



Бесплатные консультации  
для наших заказчиков:

Технологическое оборудование и расходные материалы  
для производства электроники

**8 800 555 6889**

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

[www.liontech.ru](http://www.liontech.ru)